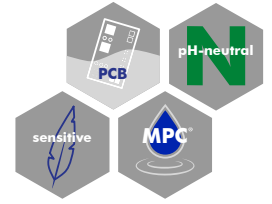


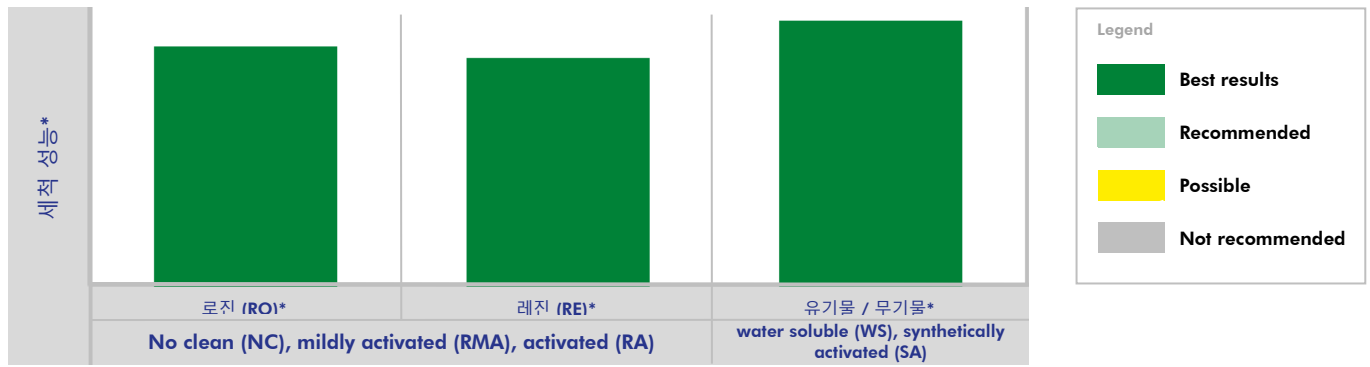
VIGON N 600



수계기반의 pH 중성 세척제

VIGON® N 600 은 pH 중성제형으로 만들어진 혁신적인 디플럭싱(defluxing) 용액입니다. 이 용액은 Inline 과 Batch 타입의 스프레이 분사 방식 세척을 위해 개발되었고, 딥 탱크 과정에서 또한 적용 가능합니다. pH 중성 상태에서 전자 어셈블리에 남아있는 다양한 종류의 플럭스 잔사를 우수한 세척력으로 제거합니다. 또한, pH 중성 용액이기 때문에 민감한 금속과 폴리머 재료들에 대해 높은 수준의 물질 호환성을 보여줍니다.

적용 범위 - PCBA 디플럭싱(Defluxing)



* J-STD-004

다른 세척제와 비교 시 이점

- pH 중성 용액으로, VIGON® N 600 는 알루미늄, 황동, 니켈, 플라스틱, 라벨 및 잉크와 같은 민감한 물질에 대해 뛰어난 수준의 물질 호환성을 보여줍니다.
- 특정 프로세스에서 낮은 농도에서도 세척 성능이 좋습니다.
- Low standoff 부품 세척에서도 좋은 결과를 보입니다.
- 파워 전자와 플립칩 패키지 세척에도 적용됩니다.
- 파워 모듈, 리드프레임 기반 부품의 와이어 본딩 및 몰딩 품질을 향상시킵니다.
- pH 중성 형태로 하수 처리 허가를 받는 것이 더 쉽습니다.

공정 단계

세척 공정	부품	1. 세척	2. 린스	3. 건조
Spray-in-air (스프레이 분사) (inline & batch)	PCBAs, (파워 모듈, 파워 LED, 플립칩)	VIGON® N 600	DI-water ¹	Hot air
딥 탱크 (ideally with vacuum drying)	PCBAs, (파워 모듈, 리드프레임 기반 부품)	VIGON® N 600	DI-water ¹	Hot air

¹ DI-water 의 온도는 30-40°C 를 권장합니다.